2024/6/17：听单总整体讲解了一下。

1. 仪表部分
   1. 源表，2400使用GPIB，2602做了一些封装，使用起来会简单一些。
      1. 串行。发送一个指令设置电流，然后发送一个指令读取电压（如果是自己这个通道，可以直接读，如果是不同的通道，需要接线，接电阻）。优点是精度高，缺点是速度慢。
      2. Trigger。发送多个点，以及间隔周期，然后按照事先约定的周期，在最恰当的时机读取数据。有点是速度快，缺点是精度低。
   2. 光功率计
      1. 要注意Range问题，如果Range选得不对，会降低精度
   3. 品牌。KeySight前身是安捷伦
2. 光芯片部分
   1. 芯片厂设计芯片，并且会指导工艺（比如晶圆上的测试沟道）。Fab厂制造wafer。我们检测晶圆，做耦合封装，进行芯片缺陷检测（点墨）
   2. 找光：分步调整发射装置和接受装置，使得输出曲线在9个点的维度上接近高斯曲线。高斯曲线的顶点即为要找的点。
   3. 通过晶圆的新工艺，使得在晶圆测试阶段，即可完成侧向测试，从而将芯片测试部分的工作整合到晶圆测试，大大提升效率。
3. 安全问题
   1. 晶圆很贵
   2. 找原点之前，先把晶圆拿下来。
   3. 找原点时，一个轴一个轴进行